

# 鉛フリー専用ソルダペースト【 RMA タイプ 】

## FLF01-AM2030

ヌレ性をさらに向上させ、高信頼性のフラックスを開発しました。

従来の製品に比べて……

- 新開発の活性剤を使用したことにより N2リフロー、  
大気においても十分なヌレが得られます。
- 熱ダレを抑え無酸化粉末を使用することにより  
ソルダーボールの発生が低減しました。
- フラックスの吸湿を極力抑えているため、腐食が起こりにくく、  
絶縁性に優れている高信頼性の RMA タイプです。



### 特性値

		FLF01-AM2030	規 格
			JIS Z3284/Z3197
合金組成 (FLF01)		Sn 96.5%-Ag 3.0%-Cu 0.5%	—
フラックス含有量 (%)		10.5~11.5	—
粘 度		140~200Pa・S	PCU-2 計 (10rpm 3 分値)
粉末粒度		25~38 μm	22~38 μm
乾 燥 度		合 格	粉末タルクがブラッシングによって容易に除去できること
ハライド含有量 (%)		0.1	0.1±0.01
銅板腐食試験		合 格	腐食が大でないこと
水溶液抵抗 (Ω・m)		合 格	1,000 以上
絶縁抵抗 (Ω)※1	条件 A	2 × 10 <sup>11</sup> 以上	1 × 10 <sup>10</sup> 以上
	条件 B	2 × 10 <sup>9</sup> 以上	1 × 10 <sup>8</sup> 以上
電圧印加耐湿性-マイグレーション		合 格	樹枝状の金属の生成が認められないこと
広 が り 率 (%)		80~85	80 以上 (銅板)

※1 絶縁抵抗試験条件 : 条件 A 温度 40℃ / 湿度 90% / 168 時間 (槽中測定)  
条件 B 温度 85℃ / 湿度 85% / 168 時間 (槽中測定)

### ソルダーボール試験

#### ●試験方法

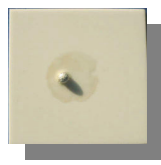
ソルダペーストをはんだのぬれない基板上で熔融させ、  
はんだ粒子が凝集する性能を測定。

#### ●試験結果

印刷後 48 時間経過後もフラックスの効力が維持されソルダー  
ボールの発生がありません。



印刷直後



48 時間後

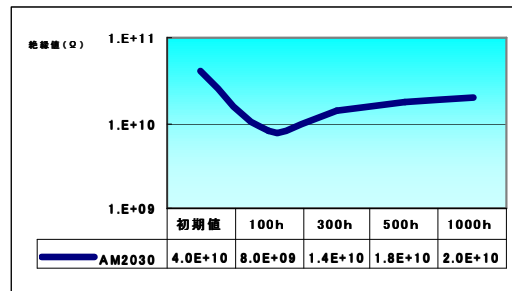
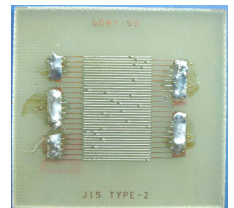
### 信頼性試験 『長期マイグレーションテスト』

#### ●試験条件

温度 85℃、湿度 85%、  
印加電圧 50V(DC)、測定電圧 100V(DC)  
基板 JIS II 型構型、DC100V 印加後 1 分値

#### ●試験結果

試験終了までマイグレーションの発生がなく、高信頼性が確認されました。



松尾ハンダ株式会社



本社工場 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2775 番地  
TEL : 046-274-0706 / FAX : 046-274-9017  
http://www.matsuo21.com / E-mail : info@matsuo21.com

このカタログに記載してある仕様につきましては、予告なく  
一部変更することがありますのでご了承下さい。